



(43) 国際公開日
2005 年 3 月 31 日 (31.03.2005)

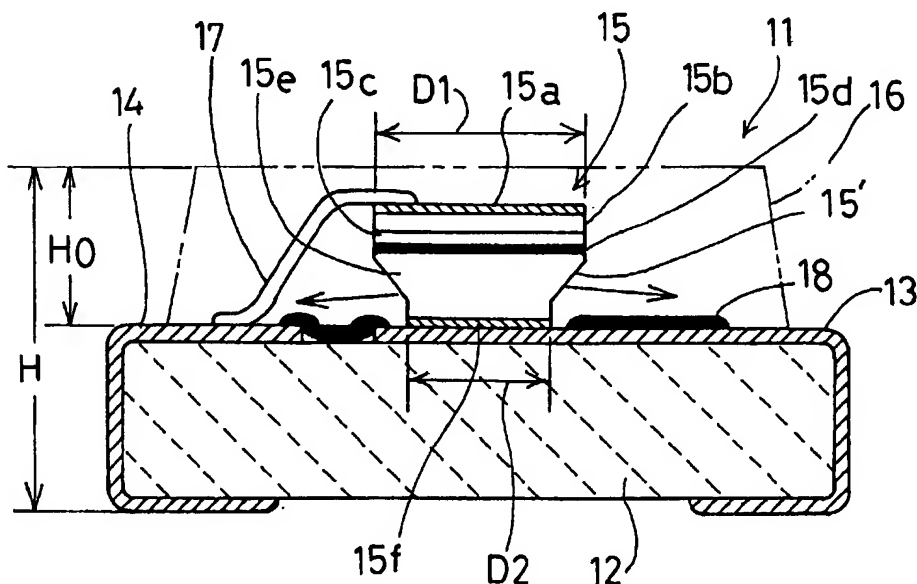
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/029600 A1

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| (51) 国際特許分類: | H01L 33/00 | (74) 代理人: 石井 暁夫, 外(ISHII, Akeo et al.); 〒5300041
大阪府大阪市北区天神橋 2 丁目北 1 番 2 1 号八千代
ビル東館 Osaka (JP). |
| (21) 国際出願番号: | PCT/JP2004/007932 | |
| (22) 国際出願日: | 2004 年 6 月 7 日 (07.06.2004) | (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW. |
| (25) 国際出願の言語: | 日本語 | |
| (26) 国際公開の言語: | 日本語 | |
| (30) 優先権データ: | | (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, |
| 特願 2003-331980 | 2003 年 9 月 24 日 (24.09.2003) JP | |
| (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ローム
株式会社 (ROHM CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6158585 京都
府京都市右京区西院溝崎町 2 1 番地 Kyoto (JP). | | |
| (72) 発明者; および | | |
| (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 板井 順一 (ITAI,
Junichi) [JP/JP]; 〒6158585 京都府京都市右京区西院
溝崎町 2 1 番地 ローム株式会社 内 Kyoto (JP). | | |

(54) Title: CHIP TYPE LED

(54) 発明の名称: チップ型LED



(57) Abstract: A chip type LED comprises an insulating substrate (12), a light emitting diode chip (15) mounted on the upper surface thereof, and a transparent package body (16) provided on the upper surface of the insulating substrate to seal the light emitting diode chip hermetically. The chip type LED is made thin when the light emitting diode chip is arranged to emit light laterally. The light emitting diode chip (15) is mounted on the upper surface of the insulating substrate while directing the anode electrode (15f) downward and directing the cathode electrode (15a) upward.

WO 2005/029600 A1

〔統葉有〕



IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(57) 要約: 絶縁基板 12 と、その上面に搭載した発光ダイオードチップ 15 と、前記絶縁基板の上面に前記発光ダイオードチップを密封するように設けた透明体によるパッケージ体 16 とから成るチップ型LEDにおいて、前記発光ダイオードチップで発光する光を横向きに出射するように構成する場合に、このチップ型LEDを薄型に構成する。前記発光ダイオードチップ 15 を、前記絶縁基板の上面に、当該発光ダイオードチップにおけるアノード電極 15 f を下向きに、カソード電極 15 a を上向きにして搭載する。